

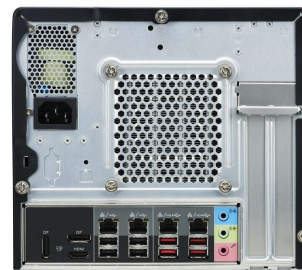
BAREBONE

XPC cube

SW580R8

14-LITER CUBE FÜR SERVER- UND WORKSTATION-ANWENDUNGEN

Das Shuttle XPC Barebone SW580R8 unterstützt wie sein Schwestermmodell SH570R8 Intel Core Prozessoren der 10./11. Generation, vier große 3,5"-Festplatten mit Raid-Funktion, 128 GB DDR4-3200 RAM und Dual-Slot-Grafikkarten. Darüber hinaus eignen sich für das SW580R8 auch Prozessoren der Xeon-W-Serie mit ECC- und vPro-Unterstützung für mehr Systemstabilität und Fernwartungsmöglichkeiten. Außerdem bietet es erstmals vier Netzwerkanschlüsse (davon zwei mit 2,5 GBit/s), einen zweiten M.2-Slot für SSD-Karten und einen TPM-Sicherheitschip. Eine derart üppige Performance und Ausstattung in einem Aluminiumgehäuse mit nur 14 Liter Volumen macht SW580R8 zur idealen Plattform für anspruchsvolle Mini-Server und Workstation-PCs mit Top-Zuverlässigkeit auch unter hoher Belastung.



WÜRFELDESIGN

■ Schwarzes Gehäuse aus Aluminium ■ Abmessungen: 33,2 x 21,5 x 19 cm (LBH), ca. 13,6 Liter ■ Betriebstemperatur: 0-40 °C (nicht kond.)

BETRIEBSSYSTEM

■ Ein Betriebssystem ist nicht enthalten
■ Unterstützt Windows 10/11 und Linux (64-Bit)

PROZESSOR SUPPORT

■ Sockel LGA1200 unterstützt Intel Core W-Serie Prozessoren und Intel Core i9/i7/i5/i3, Pentium Gold und Celeron processors der 10./11. Generation "Comet Lake-S" und "Rocket Lake-S" mit max. 125W TDP
■ Heatpipe-Kühlsystem

CHIPSATZ & GRAFIK

■ Intel W580 Chipsatz ■ Unterstützt Intel vPro/AMT mit passender Software und CPU ■ Integrierte Intel UHD-Grafik, unterstützt 4K (Achtung: Core CPUs der "F"-Serie bieten keine integrierte Grafik)

SPEICHER SUPPORT

■ Vier 288-Pin DIMM-Steckplätze ■ Gesamtkapazität maximal 128 GB (max. 32 GB pro Modul) ■ Unterstützt DDR4-2666/2933/3200
■ Unterstützt ECC-Speicher zusammen mit Intel XEON Prozessoren

PCI-EXPRESS STECKPLÄTZE

■ 1x PCIe X16 v3/v4 Slot unterstützt Dual-Slot Grafikkarten mit bis zu 28 x 12 x 4 cm (LBH), mit 6-pol. und 8-pol Power-Anschluss
■ 1x PCIe X4 v3 slot (nicht nutzbar bei Dual-Slot Grafikkarte)

LAUFWERKE – SATA / M.2

■ Schächte: 4x 3,5" (intern), onboard: 4x SATA-Ports (unterstützt RAID)
■ 2x M.2-2280M Slot (einer unterstützt PCIe x4 v3/v4 NVMe)
■ 1x M.2-2230E für optionales WLAN (Zubehör: WLN-M)

ANSCHLÜSSE

■ HDMI 1.4b/2.0b ■ 2x DisplayPort 1.4 ■ 4x USB 3.2 Gen2 ■ 4x USB 3.2 Gen1 (1x Typ-C) ■ 4x USB 2.0 ■ 1x interner USB 2.0 ■ 4x RJ45 LAN Ports (2x Intel Gigabit und 2x Realtek 2.5G) ■ 5x Audio Port (2x vorne, 3x hinten) ■ Anschluss für externen Power-Button

NETZTEIL

■ Internes 500W Netzteil, 80Plus Gold

OPTIONALES ZUBEHÖR

■ WLAN-Kit (WLN-M (ac)/WLN-M1 (ax)) ■ RS232 COM Port (H-RS232)
■ Adapter für zwei 2,5"-Laufwerke (PHD3) ■ 850W Netzteil (PC850)
■ Kabel für externen Power-Button (CXP01)

Bemerkung: die rot markierten Leistungsmerkmale stehen nur in Kombination mit einem Gen 11 "Rocket Lake-S" Prozessor zur Verfügung.

Shuttle XPC cubes mit Intel 5xx Chipsätzen

Produkt	CPU Sockel	Xeon	Chip	Gehäuse	Laufwerksschächte	Intel LAN	vPro	ECC	Netzteil	UPC Code
SH510R4	LGA 1200	—	H510	R4	5,25" + 2x 3,5"	1x	—	—	300 W, 80+ Bronze	887993003948
SH570R6	LGA 1200	—	H570	R6	5,25" + 2x 3,5"	2x	—	—	300 W, 80+ Bronze	887993003498
SH570R6 Plus	LGA 1200	—	H570	R6	5,25" + 2x 3,5"	2x	—	—	500 W, 80+ Gold	887993003870
SH570R8	LGA 1200	—	H570	R8	4x 3,5"	2x	—	—	500 W, 80+ Gold	887993003504
SW580R8	LGA 1200	Ja	W580	R8	4x 3,5"	4x (2x 2,5G)	Ja	Ja	500 W, 80+ Gold	887993004174

BENÖTIGTE KOMPONENTEN

Es werden nur wenige Komponenten benötigt, um einen lauffähigen Mini-PC zu erhalten:

Shuttle XPC Cube Barebone SW580R8

(Foto ohne Gehäusedeckel)



LGA1200 Prozessor

Unterstützt Intel Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold oder Celeron oder Intel Xeon W-Series Prozessoren
Gen 10 "Comet Lake" oder Gen 11 "Rocket Lake"
TDP max. 125 W



Speichermodule

Bis zu vier 288-Pin DIMM Speichermodule, jeweils max. 32 GB
Unterstützt DDR4-3200 Taktrate mit Gen 11 CPUs
Unterstützt DDR4-2933/2666 Taktrate mit Gen 10 CPUs
Unterstützt ECC-Speichermodule mit Intel Xeon Prozessoren



SATA-Laufwerke

Die Laufwerkshalterung unterstützt vier 3,5"-Laufwerke.

Bemerkung: mit dem optionalen Zubehör PHD3 lassen sich zwei 2,5"-Laufwerke (Festplatten oder SSDs) in einen 3,5"-Schacht installieren. Das Mainboard verfügt über vier SATA-Ports und einen USB 2.0 Onboard-Anschluss.



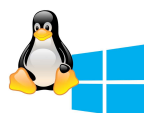
2x M.2 SSDs (optional)

Unterstützt M.2-2280/2260/2242 Formate
Unterstützt SATA oder PCIe/NVMe Schnittstellen
(mit einem Gen 10 „Comet Lake“ Prozessor unterstützt einer der beiden M.2 Sockel nur den SATA-Modus)



PCI-EXPRESS-Karten (optional)

1) PCI-E X16 Steckplatz (z.B. Single-Slot Grafikkarte)
2) PCI-E X4 Steckplatz (z.B. Dual 10 Gbit Netzwerkkarte)
Die Verlustleistung der Grafikkarte darf 300 Watt nicht überschreiten [4]. Die max. Kartenlänge beträgt 280 mm. Bei Verwendung einer Dual-Slot Grafikkarte (mit doppelter Slotbreite) kann der zweite PCI-Express-Steckplatz nicht belegt werden.



Betriebssystem

Windows 10/11 oder Linux (nur 64-Bit)

OPTIONALES ZUBEHÖR VON SHUTTLE



WLAN-Kit

WLN-M (802.11ac / Wifi 5)
WLN-M1 (802.11ax / Wifi 6)
Die M.2-2230-Karte unterstützt WLAN und Bluetooth
Enthält 2 Antennen



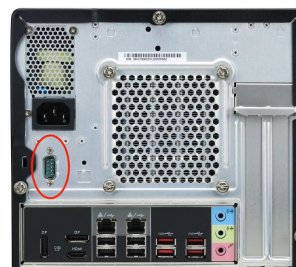
Adapter für 2,5" Laufwerke **PHD3**

Das PHD3 ermöglicht die Installation von bis zu zwei 6,35 cm (2,5") Festplatten oder SSD-Laufwerken in einem 8,9 cm (3,5") Laufwerksschacht.



Netzteil-Upgrade **PC850**

Ein 850W-Netzteil mit 80 PLUS® Platinum Effizienz



COM Port Adapter

H-RS232

Mit H-RS232 lässt sich ein serieller COM-Port (RS232) auf der Rückseite des Gehäuses installieren.



Kabel **CXP01**

Anschlusskabel für einen externen Power-Button (ohne Button)

LEISTUNGSMERKMALE



Das R8-Gehäusedesign: stilvoll und durchdacht

Das R8-Gehäuse steht für besondere Storage-Möglichkeiten dank seiner vier Festplattenschächte und bietet unglaublich viel Freiraum für Grafikkarten. Das Frontdesign wirkt dezent und einheitlich, wobei das R8-Gehäuse auf leichtes Aluminium als edles Basis-Material setzt und durch gebürstete Oberflächen die Blicke auf sich zieht.



Integrated Cooling Engine

Damit bei diesem kleinen PC-Gehäuse eine optimale Kühlung gewährleistet werden kann, wurde für den Shuttle XPC ein besonderes Kühlsystem entwickelt und integriert. Shuttles I.C.E.-Kühlsystem mit Heatpipe-Technologie ist eine ausgeklügelte Eigenentwicklung mit hoher Effizienz und sehr niedrigem Geräuschpegel.



Was bedeutet eigentlich "Barebone"?

Das Shuttle XPC cube Barebone SW580R8 besteht aus einem stilvollen Gehäuse mit vormontiertem Mainboard, Netzteil und Kabeln. Trotz der geringen Abmessungen bietet es hervorragende Anschlussvielfalt, Funktionalität und Performance. Um ein komplettes PC-System zu erhalten, müssen nur noch wenige Standard-Komponenten entsprechend der eigenen Bedürfnisse installiert werden: Prozessor, RAM, Massenspeicher und optional eine zusätzliche Grafikkarte.

Unterstützt Intel Xeon Prozessoren und ECC-Speicher

SW580R8 ist mit dem Intel® W580 Workstation-Chipsatz ausgestattet, der Intel® Xeon® Prozessoren der W-1000 Serie und ECC-Speicher unterstützt – für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. ECC RAM-Module verwenden eine automatische Fehlerkorrektur, deren Einsatz besonders bei unternehmenskritischen Anwendungen empfohlen wird, z.B. bei industriellen Steuerungen, Sicherheitssystemen, Datenservern usw.



Unterstützt Intel® vPro™/AMT

Intel® vPro™ ist eine Markenbezeichnung für bestimmte Management- und Sicherheitstechnologien. Intel® Active Management Technology (AMT) ist ein Teil von vPro. Diese Technologie ermöglicht PC-Fernverwaltung - auch im ausgeschalteten Zustand oder bei defektem Betriebssystem. Die virtuelle Prüfung und Wiederherstellung von AMT-Plattformen im Netzwerk kann die Verfügbarkeit von PCs steigern und die Wartungskosten senken. Intel vPro benötigt passende Software und Prozessoren.



Vier Netzwerk-Anschlüsse

SW580R8 verfügt über vier Netzwerk-Ports (je zwei mit 1Gb/s- und 2,5Gb/s-Geschwindigkeit). Multi-LAN wird vorwiegend im professionellen Umfeld genutzt und es gibt mehrere Anwendungsfälle, z.B. Failover/Fallback (zwei Netzwerke, falls eins ausfällt), Redundanz/Sicherheit (getrennte Netzwerke für Produktion/Wartung oder privat/öffentlich usw.).



Reichlich Platz für anspruchsvolle Dual-Slot Grafikkarten

Das optimierte Layout in diesem kompakten PC ermöglicht sogar den Einbau von großen und leistungsfähigen Dual-Slot-Grafikkarten. Das System bietet zusätzliche 6-Pin- und 8-Pin-Anschlüsse zur Versorgung von High-Performance Grafikkarten. Die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht überschreiten: 280 x 120 x 40 mm. Eine Kompatibilitätsliste finden Sie unter global.shuttle.com.



Drei-Monitor-Betrieb und mehr

Bis zu drei Ultra-HD Monitore lassen sich gleichzeitig ohne zusätzliche Grafikkarte anschließen, sofern kein Prozessor mit "F"-Kennung verwendet wird.

In Kombination mit einer diskreten PCI-Express Grafikkarte lassen sich sogar mindestens fünf Displays anschließen. Diese Funktion basiert auf dem "Switchable Graphics"-Feature. Mit dieser Methode kann der Windows Desktop horizontal auf viele Displays verteilt werden, jedoch ist eine 2x2 Anordnung sowie der Clone-Modus auf allen Displays nicht möglich.



Externer Power-Button per Remoteleitung

Für den Fall, dass das Gerät durch räumliche Gegebenheiten (z. B. einen Festeinbau) nicht durch den frontseitig angebrachten Power-Button eingeschaltet werden kann, ist es per separater Remoteleitung startbar. Hierzu verbindet man einen Taster über die entsprechenden Pins im Backpanel des PCs. (Rastermaß: 2.54 mm). Außerdem stellt dieser Anschluss eine Clear CMOS Funktion bereit und liefert eine +5V DC Spannung für externe Geräte.

+5V voltage (2) (4) Power Button
Clear CMOS (1) (3) Ground

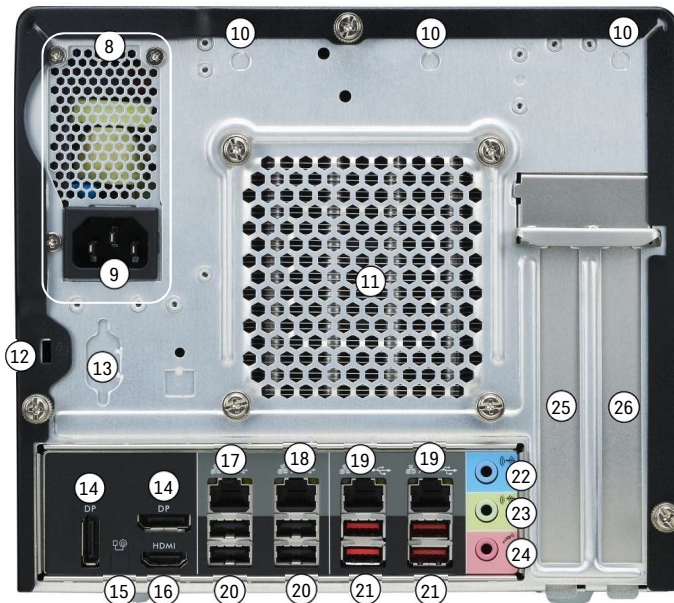
Vorder- und Rückansicht

Vorderseite



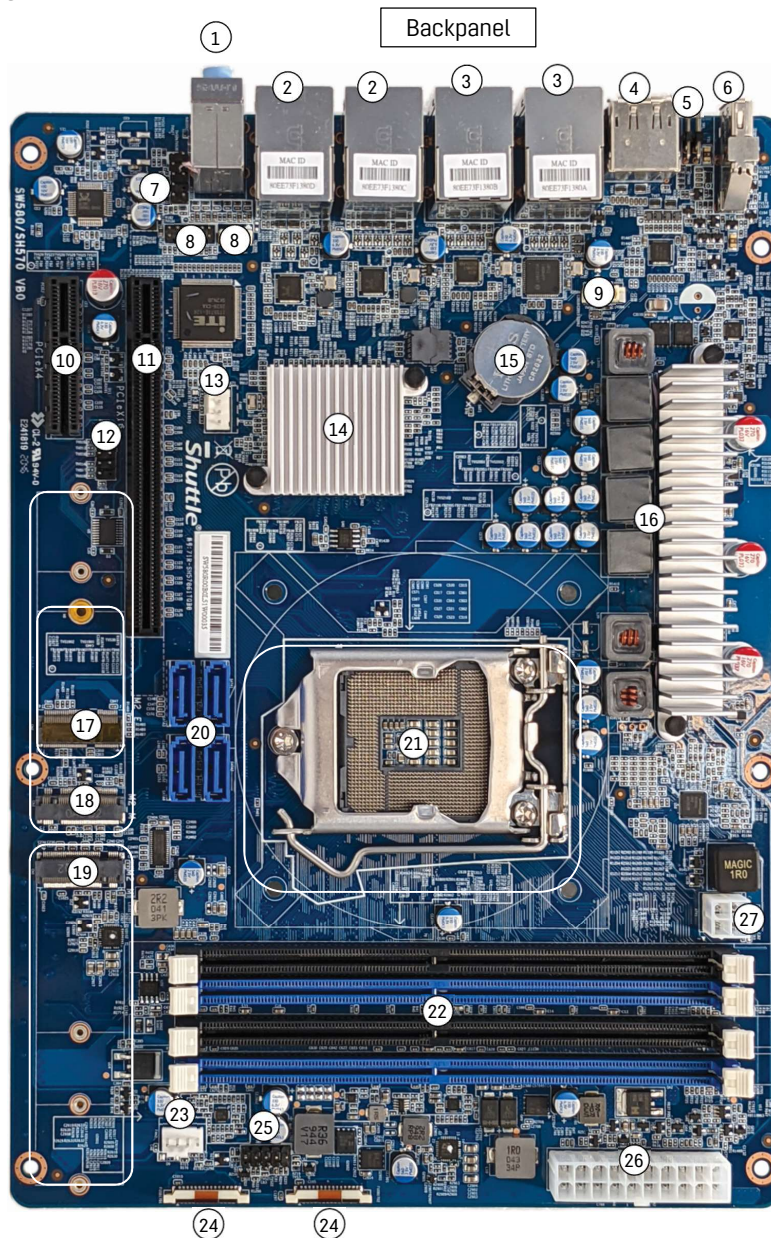
1. Festplatten/SSD-LED
2. Betriebsanzeige-LED
3. Ein-/Ausschalt-Button
4. 3x USB 3.2 Gen 1 Typ-A Port (5 Gb/s)
5. Mikrofon-Eingang
6. Kopfhörer-Ausgang
7. USB 3.2 Gen 1 Typ-C Port (5 Gb/s)

Rückseite



8. Internes Netzteil (PSU)
9. AC-Netzanschluss
10. 3x Perforation für optionale WLAN-Antenne
11. Heatpipe-Kühlsystem
12. Öffnung für das Kensington-Lock
13. Perforation für einen optionalen COM-Port
14. DisplayPort 1.4
15. Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V DC Hilfsspannung (4 Pins mit 2,54 mm Rastermaß)
16. HDMI 2.0b/1.4b
17. Gigabit Netzwerkanschluss (Intel i210AT)
18. Gigabit Netzwerkanschluss (Intel i219LM) unterstützt Intel vPro/AMT
19. 2x 2.5G Netzwerkanschluss (Realtek 8125b)
20. 4x USB 2.0 Port
21. 4x USB 3.2 Gen 2 Typ-A Port (10 Gb/s)
22. Audio Line-in
23. Audio Line-out
24. Mikrofon-Eingang
25. PCI-Express X16 Steckplatz
26. PCI-Express X4 Steckplatz

Mainboard



- | | |
|--|---|
| 1. 3x Audio Ports (Line-in / Line-out / Mikrofon-Eingang) | 14. Intel H580 Chipsatz mit Kühlkörper |
| 2. 2x RJ45 2.5G LAN Port und
4x USB 3.2 Gen 2 Typ-A Port (10 Gb/s) | 15. CMOS-Batterie |
| 3. 2x RJ45 Gigabit LAN Port und
4x USB 2.0 Port | 16. Bereich des CPU-Spannungsreglers |
| 4. HDMI 2.0b/1.4b Port & DisplayPort 1.4 | 17. M.2-2230E Steckplatz für WLAN-Karten |
| 5. Anschluss für externen Ein-/Aus-Button, Clear CMOS und 5 V
DC Hilfsspannung (4 Pins mit 2,54 mm Rastermaß) | 18. M.2-2280M Steckplatz für SSD-Karten |
| 6. DisplayPort 1.4 | 19. M.2-2280M Steckplatz für SSD-Karten |
| 7. Audio-Anschluss für Frontpanel | 20. 4x SATA v3.0 Anschluss |
| 8. Debug-Port (reserviert) | 21. LGA1200 Prozessorsockel |
| 9. Onboard USB 2.0 Anschluss (4-Pin) | 22. 4x DIMM Speichersteckplätze |
| 10. PCI-Express X4 Erweiterungssteckplatz | 23. Anschluss für Lüfter (4-Pin) |
| 11. PCI-Express X16 Erweiterungssteckplatz | 24. Anschluss für USB 3.0-Ports auf der Vorderseite |
| 12. Onboard RS232 COM-Port (2x5-Pin) | 25. Anschluss für Buttons/LEDs auf der Vorderseite |
| 13. Anschluss für Lüfter (4-Pin) | 26. ATX-Netzteilanschluss (20-Pin) |
| | 27. ATX-Netzteilanschluss (4-Pin) |

Shuttle Produktvergleich: SH3xx versus SH5xx

Die Unterschiede bei der neueren SH5xx-Serie sind in **rot** markiert.

MODELL	SH310R4V2	SH370R6V2 PLUS	SH370R8	SH510R4	SH570R6 PLUS	SH570R8	SW580R8
GEHÄUSE	R4 Gehäuse Veränderbare Vorderseite	R6 Gehäuse mit Laufwerks- klappen	R8 Gehäuse unterstützt vier 3,5"- Festplatten	R4 Gehäuse Veränderbare Vorderseite	R6 Gehäuse mit Laufwerks- klappen	R8 Gehäuse unterstützt vier 3,5"- Festplatten	R8 Gehäuse unterstützt vier 3,5"- Festplatten
PROZESSOR SUPPORT	Socket LGA1151v2, TDP max. 95 W Codename "Coffee Lake-S" 14 nm – Gen 8/9 Supports Celeron, Pentium Gold, Core i3 / i5 / i7 / i9			Socket LGA1200, TDP max. 125 W Codename "Comet/Rocket Lake-S" 14 nm – Gen 10/11 Supports Celeron, Pentium Gold, Core i3 / i5 / i7 / i9			
XEON SUPPORT	—	—	—	—	—	—	Xeon W-Series
CPU-KÜHLUNG	3 Heatpipes	3 Heatpipes	3 Heatpipes	4 Heatpipes	4 Heatpipes	4 Heatpipes	4 Heatpipes
CHIPSATZ	Intel H310	Intel H370	Intel H370	Intel H510	Intel H570	Intel H570	Intel W580
Intel vPRO/AMT	—	—	—	—	—	—	Unterstützt
TPM 2.0	Firmware	Firmware	Firmware	Firmware	Firmware	Firmware	Hardware-Chip
BETRIEBSSYSTEM	Unterstützt Windows 10/11 and Linux (64-bit)			Unterstützt Windows 10/11 and Linux (64-bit)			
LAUFWERKS- SCHÄCHTE	1x 5.25" 2x 3.5"	1x 5.25" 2x 3.5" (1x open)	4x 3.5"	1x 5.25" 2x 3.5"	1x 5.25" 2x 3.5" (1x open)	4x 3.5"	4x 3.5"
SATA-PORTS	3	4	4	3	4	4	4
PCI-EXPRESS STECKPLÄTZE	PCIe X16 v3.0 PCIe X1 V2.0	PCIe X16 v3.0 PCIe X4 V3.0	PCIe X16 v3.0 PCIe X4 V3.0	PCIe X16 v4.0 PCIe X1 V2.0	PCIe X16 v4.0 PCIe X4 V3.0	PCIe X16 v4.0 PCIe X4 V3.0	PCIe X16 v4.0 PCIe X4 V3.0
MAX. RAM SUPPORT	2x 16 GB DDR4-2933	4x 32 GB DDR4-2933	4x 32 GB DDR4-2933	2x 32 GB DDR4-3200 [*]	4x 32 GB DDR4-3200 [*]	4x 32 GB DDR4-3200 [*]	4x 32 GB DDR4-3200 [*] Supports ECC
GRAFIK- ANSCHLÜSSE	HDMI 2.0a DP 1.2, VGA	HDMI 2.0a 2x DP 1.2	HDMI 2.0a 2x DP 1.2	HDMI 2.0b [*] DP 1.4, VGA	HDMI 2.0b [*] 2x DP 1.4	HDMI 2.0b [*] 2x DP 1.4	HDMI 2.0b [*] 2x DP 1.4
M.2 SSD SLOTS	1	1	1	1	1	1	2
M.2 WLAN SLOT	M.2-2230E			M.2-2230E			
BUTTONS / LEDS	Power-Button, LEDs für Power-On/Speicherzugriff			Power-Button, LEDs für Power-On/Speicherzugriff			
USB 3.2 GEN 2	—	4	4	—	4	4	4
USB 3.2 GEN 1	4	4	4	4	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)	4 (1x Typ-C)
USB 2.0	4	4	4	4	4	4	4
USB 2.0 onboard	1	2	2	1	1	1	1
1G NETZWERK	1x Intel i219LM	2x Intel 211	2x Intel 211	1x Intel i219LM	1x Intel i210AT 1x Intel i219LM	1x Intel i210AT 1x Intel i219LM	1x Intel i210AT 1x Intel i219LM
2.5G NETZWERK	—	—	—	—	—	—	2x RTL 8125b
AUDIO	Mikrofon-Eing., Kopfhörer-Ausgang, 6-Kanal Line-Out			Mikrofon -Eing., Kopfhörer-Ausgang, 6-Kanal Line-Out			
OPTIONALES ZUBEHÖR	WLAN Kit: WLN-M (ac) / WLN-M1 (ax) COM-Port: H-RS232 3,5"/2,5" Adapter: PHD3			WLAN Kit: WLN-M (ac) / WLN-M1 (ax) COM-Port: H-RS232 3,5"/2,5" Adapter: PHD3 Kabel für ext. Power-Button: CXP01 850W-Netzteil: PC850			
NETZTEIL	300W 80+ Bronze	Standard: 300W Plus: 500W	500 W 80+ Gold	300W 80+ Bronze	Standard: 300W Plus: 500W	500 W 80+ Gold	500 W 80+ Gold

[*] Bemerkung: Die **SH5xx-Serie** unterstützt PCIe X16 **V4** Slot, DDR4-**3200** und HDMI **2.0b** mit **Gen. 11** Prozessoren "**Rocket Lake-S**", jedoch lediglich PCIe X16 **V3** Slot, DDR4-**2666/2933** und HDMI **1.4b** mit **Gen. 10** Prozessoren "**Comet Lake-S**".

SHUTTLE XPC CUBE BAREBONE SW580R8 — SPEZIFIKATION

GEHÄUSE	Schwarzes Aluminium-Gehäuse Vorderseite: gebürstetes Aluminium Abdeckklappe auf der Vorderseite für die Media-Ports (USB und Audio) Kensington Sicherheits-Slot auf der Gehäuserückseite (auch: K-Slot oder Kensington Lock) als Teil einer Diebstahlsicherung Abmessungen: 33,2 x 21,5 x 19,0 cm (LBH ohne Füße) = 13,6 Liter Höhe mit Gummifüßen: 19,7 cm Gewicht: 3,5 kg netto / 4,5 kg brutto
MAINBOARD / CHIPSATZ	Mainboard mit Shuttle-eigenem Format, spezielles Design für XPC Barebone SW570R8 Chipsatz/Southbridge: Intel® W580 Passive Chipsatz-Kühlung mit Kühlkörper Die Northbridge ist im Prozessor integriert. Mit Feststoffelektrolytkondensatoren (Solid Capacitors) - diese Kondensatoren sind hitzebeständiger und langlebiger
BIOS	AMI BIOS, SPI-Interface, 16 MB Flash-EEPROM-Baustein Unterstützt Hardware-Überwachung, Watchdog Unterstützt Neustart nach Stromausfall (Power Fail Resume) Unterstützt Booten vom externem Flashspeicher über USB Unterstützt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
UNTERSTÜTZT INTEL® vPro™ UND AMT	Intel® vPro™ ist eine Markenbezeichnung für bestimmte Management- und Sicherheitstechnologien. Intel® Active Management Technology (AMT) ist ein Teil von vPro. Diese Technologie ermöglicht PC-Fernverwaltung - auch im ausgeschalteten Zustand oder bei defektem Betriebssystem. Die virtuelle Prüfung und Wiederherstellung von AMT-Plattformen im Netzwerk kann die Verfügbarkeit von PCs steigern und die Wartungskosten senken. Bemerkung: Intel vPro benötigt passende Software und Prozessoren. Die Intel® MEBX Benutzeroberfläche wird aufgerufen, indem man zu Beginn des Bootvorgangs STRG-P drückt. Nur Intel Xeon- oder bestimmte Core i5/i7/i9-Prozessoren unterstützen die Intel vPro® Funktion. Nur der Intel i219 Netzwerk-Chip unterstützt die Intel vPro® Funktion. Verwenden Sie hierfür den zweiten LAN-Port von links.
TPM-MODUL	Hardware Trusted Platform Module (Infineon SLB9670VQ2, TPM 2.0)
NETZTEIL	Eingebautes 500 Watt Mini-Schaltnetzteil [4] Eingangsspannung: unterstützt 100-240V AC, 50-60 Hz 80 PLUS Gold konform Active PFC-Schaltung (Leistungsfaktor-Korrektur) ATX-Netzteil-Anschlüsse: 2x10 und 2x2 polig Stromanschluss für Grafikkarte: 6-polig und 8-polig Weitere Anschlüsse: 4x SATA, 2x Molex
BETRIEBSSYSTEM	Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Es ist kompatibel mit Windows 10/11 und Linux (64 Bit)
PROZESSOR UNTERSTÜTZUNG	Prozessor Sockel LGA 1200 Unterstützt Intel Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium Gold und Celeron Prozessoren Unterstützt Intel Xeon Prozessoren der W-Serie (W12xx und W13xx Serie) Unterstützt die 10. und 11. Generation Intel Core Prozessoren mit dem Codenamen "Comet Lake" und "Rocket Lake" und 14++ nm Technologie Maximal unterstützte Prozessor-Verlustleistung (TDP) = 125 W. Bis zu 10 CPU-Kerne, 20 Threads und 20 MB L3-Cache Unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie. Der Prozessor integriert die Controller für PCI-Express und Speicher und die Grafikfunktion auf dem gleichen Halbleiter-Chip. Prozessoren mit "F"-Kennung unterstützen jedoch keine integrierte Grafik [2] (die Leistungsmerkmale hängen vom Prozessormodell ab). Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.
HEATPIPE PROZESSORKÜHLUNG	Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine) I.C.E. Heatpipe Kühl-Technologie mit linear geregelter 9,2 cm Lüfter SilentX-Technologie für eine effizientere und leisere Kühlung

SPEICHER- UNTERSTÜTZUNG	4x 288-Pin DIMM-Steckplätze Unterstützt DDR4-Speicher mit 1,2 V Unterstützt Dual-Channel-Modus Unterstützt maximal 32 GB per Steckplatz, Gesamtkapazität maximal 128 GB Die <u>maximale DDR4-Taktfrequenz</u> hängt vom verwendeten Prozessortyp ab: - Gen. 11 "Rocket Lake" unterstützt DDR4-3200 (PC4-25600U) - Gen. 10 "Comet Lake" Core i7/i9 unterstützt DDR4-2933 (PC4-23433U) - andere Gen. 10 "Comet Lake" unterstützen DDR4-2666 (PC4-21300U) Unterstützt unbuffered ECC-Speicher in Verbindung mit Xeon-Prozessoren
PCI-E EXPANSION SLOTS	1x PCI-Express x16 v4.0 Steckplatz (unterstützt lediglich PCI-Express <u>v3.0</u> mit Gen. 10 "Comet Lake" Prozessoren) 1x PCI-Express x4 v3.0 Steckplatz, halboffen Es werden Grafikkarten mit doppelter Slotbreite unterstützt, in diesem Fall kann der zweite PCI-Express-Steckplatz allerdings nicht belegt werden. Die Grafikkarte darf folgende Abmessungen nicht überschreiten: 280 x 120 x 40 mm. Stromanschluss für Grafikkarte: 6-polig und 8-polig [4]
INTEGRIERTE GRAFIKFUNKTION (OPTIONAL [2])	Die Eigenschaften der integrierten Intel UHD Grafikfunktion hängen vom verwendeten Prozessortyp ab. Einige Prozessormodelle bieten keine integrierte Grafikfunktion [2] Der PC bietet drei Video-Ausgänge, die UltraHD 2160p/60 unterstützen: - 1x HDMI v2.0b (nur HDMI v1.4b mit Gen. 10 "Comet Lake" Prozessoren) - 2x DisplayPort v1.4 Unterstützt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung (2160p/60) Unterstützt drei unabhängige Displays über die integrierte Grafikfunktion Unterstützt weitere Displays zusammen mit externer Grafikkarte Hardware Video Decoding/Encoding DisplayPort und HDMI unterstützen Multikanal Digital Audio über das gleiche Kabel
LAUFWERKSSCHÄCHTE	Laufwerksschächte: 4x 3,5" (intern) Mit dem optionalen Zubehör PHD3 lassen sich jeweils zwei 2,5"-Laufwerke in einen 3,5"-Schacht einbauen.
SATA-ANSCHLÜSSE	4x Serial ATA 6G Onboard-Anschlüsse (rev. 3.0, max. 6 Gbit/s) Unterstützt Intel Rapid Storage Technology (RST) mit Raid 0/1/5/10, JBOD)
ZWEI M.2-2280M SSD SLOTS	Das Gerät verfügt über zwei interne M.2 2280 M Steckplätze für M.2 SSD-Karten <u>Slot 1:</u> unterstützt PCIe Gen. 4.0 X4 mit NVMe oder SATA v3.0 (unterstützt nur SATA v3.0 mit einer Gen. 10 "Comet Lake-S CPU) <u>Slot 2:</u> unterstützt PCIe Gen. 3.0 X4 mit NVMe oder SATA v3.0 Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben.
M.2-2230E SLOT	M.2-2230E-Steckplatz für WLAN-Karten Schnittstellen: PCI-Express Gen. 3.0 X1 und USB 2.0 Vverwendete M.2-2230-Steckkarten müssen 22 mm breit und 30 mm lang sein (Typ 2230) Unterstützt WLAN-Erweiterungskarten (Optionales Shuttle-Zubehör: WLN-M)
HD AUDIO	Audio Codec: Realtek ALC897, 5.1-Kanal Drei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Rückseite: Line-in (blau), Line-out (grün) und Mikrofon-Eingang (rosa) umschaltbar auf 5.1 Line-out (front, hinten, Mitte/Bass) Auf der Vorderseite: Mikrofon-Eingang und Kopfhörer-Ausgang (Line-out)
VIER NETZWERK- ANSCHLÜSSE	Das Gerät verfügt über vier RJ45-LAN-Anschlüsse für Ethernet Netzwerk <u>Port 1+2:</u> Intel 210AT / 219LM - unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate (die LED leuchtet grün/orange bei 100M/1G-Geschwindigkeit) <u>Port 3+4:</u> Realtek 8125b - unterstützt 10 / 100 / 1.000 / 2.500 MBit/s (die LED leuchtet grün/orange bei 1G/2.5G-Geschwindigkeit) Datentransferrate Unterstützt WAKE ON LAN (WOL) Unterstützt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE) Der Teaming-Modus ist jeweils für Port 1+2 und für Port 3+4 möglich [3]
ANSCHLÜSSE VORDERSEITE	Mikrofon-Eingang (3,5 mm) Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm) 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Typ C 3x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Typ A, Blau Ein/Aus-Button, Betriebsanzeige (Blaue LED) Aktivitätsanzeige für Festplatte (Gelbe LED)

ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE	1x HDMI 2.0b (HDMI 1.4b mit Gen. 10 "Comet Lake" Prozessor) 2x DisplayPort 1.4 [1] 4x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), Typ A, rot 4x USB 2.0, Typ A, schwarz 2x Gigabit LAN (RJ45) 2x 2.5G LAN (RJ45) Audio Line-out (3,5 mm) Audio Line-in (3,5 mm) Mikrofon-Eingang (3,5 mm) 1x 4-Pin-Anschluss (2,54 mm Rastermaß) unterstützt: - externen Einschalt-Taster - Clear CMOS Funktion - 5V DC Spannung für externe Komponenten Optional: Serielle RS232 Schnittstelle (Zubehör: "H-RS232") 3x Perforation für optionale WLAN-Antennen (Zubehör: "WLN-M")
WEITERE ANSCHLÜSSE ONBOARD	Belegte Front-Panel-Anschlüsse für USB, Audio, Buttons, LEDs 1x RS232, serielle Schnittstelle (2x5 Pins) 2x Lüfter-Anschlüsse (4 Pins) 1x USB 2.0 (4 Pins)
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	Mehrsprachiges XPC Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC) Windows 64-Bit Treiber-DVD 2x Serial-ATA Laufwerkskabel 230V-Netzkabel (mit Schutzkontakt) Wärmeleitpaste Schutzkappe für den CPU-Sockel (nicht verwenden, falls Heatpipe oder Kühler installiert sind) Tüte mit Schrauben
OPTIONALES ZUBEHÖR	Backpanel-Adapter für eine serielle RS232 Schnittstelle (H-RS232) WLAN-Kit unterstützt WLAN und Bluetooth mit zwei externen Antennen (WLN-M (802.11ac) und WLN-M1 (802.11ax)) Adapter für 2,5"-Laufwerke wie z.B. SSD-Laufwerke (PHD3) Adapterkabel für einen externen Power-Button (CXP01) 850W-Netzteil (PC850)
UMGEBUNGS- PARAMETER	Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: 0-40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-90 %
ZERTIFIKATE / KONFORMITÄT	EMI: FCC, CE, BSMI, C-Tick Sicherheit: CB, BSMI, ETL Weitere: RoHS, Energy Star, ErP Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- u. Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) (2) Richtlinie 2014/35/EU über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD) (3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP).

[1] DisplayPort in HDMI/DVI konvertieren

Der DisplayPort Ausgang kann mit einem günstigen, passiven Adapterkabel in HDMI oder DVI konvertiert werden. Zum Beispiel:

DELOCK 82590: 1 m, DisplayPort (männl., 20P) zu HDMI-A (männl., 19P)

DELOCK 82435: 5 m, DisplayPort (männl., 20P) zu DVI-D (männl., 24P)

Die integrierte Grafikfunktion erkennt die Eigenschaft des angeschlossenen Displays und gibt das passende elektrische Signal aus - entweder DisplayPort (ohne Adapter) oder HDMI/DVI (mit Adapter).

Umgekehrt kann ein Bildschirm mit DisplayPort nicht über einen einfachen, passiven Adapter an den HDMI-Ausgang angeschlossen werden.

[2] Integrierte Grafik ist optional

Hinweis: Prozessoren, deren Modellbezeichnung mit "F" endet (z.B. Intel Core i5-11600F), haben keine integrierte Grafikfunktion, so dass die Grafikausgänge des Shuttle XPCs keine Funktion haben. In diesem Fall ist eine zusätzliche diskrete PCIe-Grafikkarte zwingend erforderlich.

[3] Teaming Modus

Mit der Teaming-Funktion lassen sich beide Netzwerk-Schnittstellen zu einem logischen Netzwerkadapter zusammenfassen, der eine Redundanz erlaubt. Der Vorteil davon ist, dass dadurch Load Balancing (Lastausgleich) und Failover (Ausfallsicherung) ermöglicht werden.

[4] Online Power Calculator

Der PCI-Express X16 Steckplatz liefert maximal 75 Watt an die Grafikkarte, plus 75 Watt und 150 Watt über den 6-Pin- und 8-Pin-Stromanschluss vom Netzteil - die Verlustleistung der Grafikkarte darf also 300 Watt nicht überschreiten. Der Prozessor darf max. 125 Watt TDP haben. Falls leistungsstarke PC-Komponenten verwendet werden, dann prüfen Sie mit dem "Power Supply Calculator", ob das eingebaute 500-Watt-Netzteil diese Konfiguration unterstützt, siehe: <http://global.shuttle.com/support/power>. Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren und Grafikkarten finden Sie außerdem in der Support-Liste unter <http://global.shuttle.com>.

10. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Sockel LGA1200 14 nm "Comet Lake S" und "Comet Lake Refresh" Prozessorübersicht (Stand: November 2021)

PROZESSOR	MODELL	CORES/ THREADS	CPU TAKTFRQ	TURBO BOOST TAKTFRQ (2.0)	SMART CACHE	TDP	SPEICHER SUPPORT	vPRO/AMT SUPPORT	INTEGRIERTE GRAFIK MAX. TAKT
Core™ i9	10900K	10/20	3,7 GHz	5,1 GHz	20 MB	125 W	DDR4-2933	–	UHD 630 (1,2 GHz)
	10900KF	10/20	3,7 GHz	5,1 GHz	20 MB	125 W	DDR4-2933	–	Nicht vorhanden
	10900	10/20	2,8 GHz	5,0 GHz	20 MB	65 W	DDR4-2933	–	UHD 630 (1,2 GHz)
	10900F	10/20	2,8 GHz	5,0 GHz	20 MB	65 W	DDR4-2933	–	Nicht vorhanden
	10900T	10/20	1,9 GHz	4,5 GHz	20 MB	35 W	DDR4-2933	–	UHD 630 (1,2 GHz)
	10850K	10/20	3,6 GHz	5,0 GHz	20 MB	125 W	DDR4-2933	–	UHD 630 (1,2 GHz)
Core™ i7	10700K	8/16	3,8 GHz	5,0 GHz	16 MB	125 W	DDR4-2933	Ja	UHD 630 (1,2 GHz)
	10700KF	8/16	3,8 GHz	5,0 GHz	16 MB	125 W	DDR4-2933	–	Nicht vorhanden
	10700	8/16	2,9 GHz	4,7 GHz	16 MB	65 W	DDR4-2933	Ja	UHD 630 (1,2 GHz)
	10700F	8/16	2,9 GHz	4,7 GHz	16 MB	65 W	DDR4-2933	–	Nicht vorhanden
	10700T	8/16	2,0 GHz	4,4 GHz	16 MB	35 W	DDR4-2933	Ja	UHD 630 (1,2 GHz)
Core™ i5	10600K	6/12	4,1 GHz	4,8 GHz	12 MB	125 W	DDR4-2666	Ja	UHD 630 (1,2 GHz)
	10600KF	6/12	4,1 GHz	4,8 GHz	12 MB	125 W	DDR4-2666	Ja	Nicht vorhanden
	10600	6/12	3,3 GHz	4,8 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,2 GHz)
	10600T	6/12	2,4 GHz	4,0 GHz	12 MB	35 W	DDR4-2666	Ja	UHD 630 (1,2 GHz)
	10505	6/12	3,2 GHz	4,6 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	Ja	UHD 630 (1,2 GHz)
	10500	6/12	3,1 GHz	4,5 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	Ja	UHD 630 (1,15 GHz)
	10500T	6/12	2,3 GHz	3,8 GHz	12 MB	35 W	DDR4-2666	Ja	UHD 630 (1,1 GHz)
	10400	6/12	2,9 GHz	4,3 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	10400F	6/12	2,9 GHz	4,3 GHz	12 MB	65 W	DDR4-2666	–	Nicht vorhanden
	10400T	6/12	2,0 GHz	3,6 GHz	12 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
Core™ i3	10325	4/8	3,9 GHz	4,7 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,15 GHz)
	10320	4/8	3,8 GHz	4,6 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,15 GHz)
	10305	4/8	3,8 GHz	4,5 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,15 GHz)
	10305T	4/8	3,8 GHz	4,5 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	10300	4/8	3,7 GHz	4,4 GHz	8 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,15 GHz)
	10300T	4/8	3,0 GHz	3,9 GHz	8 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	10105F	4/8	3,7 GHz	4,4 GHz	6 MB	65 W	DDR4-2666	–	Nicht vorhanden
	10105	4/8	3,7 GHz	4,4 GHz	6 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	10105T	4/8	3,0 GHz	3,9 GHz	6 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	10100	4/8	3,6 GHz	4,3 GHz	6 MB	65 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	10100F	4/8	3,6 GHz	4,3 GHz	6 MB	65 W	DDR4-2666	–	Nicht vorhanden
	10100T	4/8	3,0 GHz	3,8 GHz	6 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
Pentium® Gold	G6605	2/4	4,3 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	G6600	2/4	4,2 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	G6505	2/4	4,2 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	G6500	2/4	4,1 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,1 GHz)
	G6500T	2/4	3,5 GHz	–	4 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 630 (1,05 GHz)
	G6405	2/4	4,1 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)
	G6405T	2/4	3,5 GHz	–	4 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)
	G6400	2/4	4,0 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)
	G6400T	2/4	3,4 GHz	–	4 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)

PROZESSOR	MODELL	CORES/ THREADS	CPU TAKTFRQ	TURBO BOOST TAKTFRQ (2.0)	SMART CACHE	TDP	SPEICHER SUPPORT	VPRO/AMT SUPPORT	INTEGRIERTE GRAFIK MAX. TAKT
Celeron®	G5925	2/2	3,6 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)
	G5920	2/2	3,5 GHz	–	2 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)
	G5905	2/2	3,5 GHz	–	4 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)
	G5905T	2/2	3,3 GHz	–	4 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)
	G5900	2/2	3,4 GHz	–	2 MB	58 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)
	G5900T	2/2	3,2 GHz	–	2 MB	35 W	DDR4-2666	–	UHD 610 (1,05 GHz)

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, T = stromsparend, F = ohne integrierte Grafikfunktion, TDP = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).
Hinweis: Das Shuttle XPC cube Barebone SW580R8 unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie
 Intel Prozessoren ohne integrierte Grafikfunktion sind erkennbar an dem Buchstaben "F" in der Prozessorbezeichnung. Bei Verwendung dieser CPU ist eine Grafikkarte erforderlich.

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.

11. GENERATION DER INTEL CORE DESKTOP PROZESSOR-FAMILIE

Socket LGA1200 14 nm "Rocket Lake S" Prozessorübersicht (Stand: November 2021)

PROZESSOR	MODELL	CORES/ THREADS	CPU TAKTFRQ	TURBO BOOST TAKTFRQ (2.0)	SMART CACHE	TDP	SPEICHER SUPPORT	VPRO/AMT SUPPORT	INTEGRIERTE GRAFIK MAX. TAKT
Core™ i9	11900K	8/16	3,5 GHz	5,3 GHz	16 MB	125 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
	11900KF	8/16	3,5 GHz	5,3 GHz	16 MB	125 W	DDR4-3200	–	Nicht vorhanden
	11900	8/16	2,5 GHz	5,2 GHz	16 MB	65 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
	11900F	8/16	2,5 GHz	5,2 GHz	16 MB	65 W	DDR4-3200	–	Nicht vorhanden
	11900T	8/16	1,5 GHz	4,9 GHz	16 MB	35 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
Core™ i7	11700K	8/16	3,6 GHz	5,0 GHz	16 MB	125 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
	11700KF	8/16	3,6 GHz	5,0 GHz	16 MB	125 W	DDR4-3200	–	Nicht vorhanden
	11700	8/16	2,5 GHz	4,9 GHz	16 MB	65 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
	11700F	8/16	2,5 GHz	4,9 GHz	16 MB	65 W	DDR4-3200	–	Nicht vorhanden
	11700T	8/16	1,4 GHz	4,6 GHz	16 MB	35 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
Core™ i5	11600K	6/12	3,9 GHz	4,9 GHz	12 MB	125 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
	11600KF	6/12	3,9 GHz	4,9 GHz	12 MB	125 W	DDR4-3200	–	Nicht vorhanden
	11600	6/12	2,8 GHz	4,8 GHz	12 MB	65 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
	11600T	6/12	1,7 GHz	4,1 GHz	12 MB	35 W	DDR4-3200	–	UHD 750 (1,3 GHz)
	11500K	6/12	3,9 GHz	4,9 GHz	12 MB	95 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
	11500	6/12	2,7 GHz	4,6 GHz	12 MB	65 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,3 GHz)
	11500T	6/12	1,5 GHz	3,9 GHz	12 MB	35 W	DDR4-3200	Ja	UHD 750 (1,2 GHz)
	11400	6/12	2,6 GHz	4,4 GHz	12 MB	65 W	DDR4-3200	–	UHD 730 (1,3 GHz)
	11400F	6/12	2,6 GHz	4,4 GHz	12 MB	65 W	DDR4-3200	–	Nicht vorhanden
	11400T	6/12	1,3 GHz	3,7 GHz	12 MB	35 W	DDR4-3200	–	UHD 730 (1,2 GHz)

K = unlocked: einstellbarer Takt-Multiplikator, T = stromsparend, F = ohne integrierte Grafikfunktion, TDP = Thermal Design Power (max. Verlustleistung).
Hinweis: Das Shuttle XPC cube Barebone SW580R8 unterstützt nicht die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie
 Intel Prozessoren ohne integrierte Grafikfunktion sind erkennbar an dem Buchstaben "F" in der Prozessorbezeichnung. Bei Verwendung dieser CPU ist eine Grafikkarte erforderlich.

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.

10. GENERATION INTEL XEON W PROZESSOR-FAMILIE

Sockel LGA1200 14 nm "Comet Lake" Prozessorübersicht (Stand: November 2021)

PROZESSOR	MODELL	CORES/ THREADS	CPU TAKTFRQ	TURBO BOOST TAKTFRQ (2.0)	SMART CACHE	TDP	SPEICHER SUPPORT	vPRO/AMT SUPPORT	INTEGR. GRAFIK MAX. TAKT
Xeon®	W-1290TE	10	1,8 GHz	4,5 GHz	20 MB	35 W	DDR4-2933 ECC	Ja	HD 630 (1,2 GHz)
	W-1290P	10	3,7 GHz	5,3 GHz	20 MB	125 W	DDR4-2933 ECC	Ja	HD P630 (1,2 GHz)
	W-1290	10	3,2 GHz	5,2 GHz	20 MB	80 W	DDR4-2933 ECC	Ja	HD P630 (1,2 GHz)
	W-1290T	10	1,9 GHz	4,7 GHz	20 MB	35 W	DDR4-2666 ECC	Ja	HD P630 (1,2 GHz)
	W-1290E	10	3,5 GHz	4,8 GHz	20 MB	95 W	DDR4-2933 ECC	Ja	HD 630 (1,2 GHz)
	W-1270	8	3,4 GHz	5,0 GHz	16 MB	80 W	DDR4-2933 ECC	Ja	HD P630 (1,2 GHz)
	W-1270P	8	3,8 GHz	5,1 GHz	16 MB	125 W	DDR4-2933 ECC	Ja	HD P630 (1,2 GHz)
	W-1270E	8	3,4 GHz	4,8 GHz	16 MB	80 W	DDR4-2933 ECC	Ja	HD 630 (1,2 GHz)
	W-1270TE	8	2,0 GHz	4,4 GHz	16 MB	35 W	DDR4-2933 ECC	Ja	HD 630 (1,15 GHz)
	W-1250	6	3,3 GHz	4,7 GHz	12 MB	80 W	DDR4-2666 ECC	Ja	HD P630 (1,2 GHz)
	W-1250P	6	4,1 GHz	4,8 GHz	12 MB	125 W	DDR4-2666 ECC	Ja	HD P630 (1,2 GHz)
	W-1250E	6	3,5 GHz	4,7 GHz	12 MB	80 W	DDR4-2666 ECC	Ja	HD 630 (1,2 GHz)
	W-1250TE	6	2,4 GHz	3,8 GHz	12 MB	35 W	DDR4-2666 ECC	Ja	HD 630 (1,15 GHz)

11. GENERATION INTEL XEON W PROZESSOR-FAMILIE

Sockel LGA1200 14 nm "Rocket Lake" Prozessorübersicht (Stand: November 2021)

PROZESSOR	MODELL	CORES/ THREADS	CPU TAKTFRQ	TURBO BOOST TAKTFRQ (2.0)	SMART CACHE	TDP	SPEICHER SUPPORT	vPRO/AMT SUPPORT	INTEGR. GRAFIK MAX. TAKT
Xeon®	W-1390P	8	3,5 GHz	5,3 GHz	16 MB	125 W	DDR4-3200 ECC	Ja	UHD P750 (1,3 GHz)
	W-1390T	8	1,5 GHz	4,9 GHz	16 MB	35 W	DDR4-3200 ECC	Ja	UHD P750 (1,3 GHz)
	W-1390	8	2,8 GHz	5,2 GHz	16 MB	80 W	DDR4-3200 ECC	Ja	UHD P750 (1,3 GHz)
	W-1370	8	2,9 GHz	5,1 GHz	16 MB	80 W	DDR4-3200 ECC	Ja	UHD P750 (1,3 GHz)
	W-1370P	8	3,6 GHz	5,2 GHz	16 MB	125 W	DDR4-3200 ECC	Ja	UHD P750 (1,3 GHz)
	W-1350P	6	4,0 GHz	5,1 GHz	12 MB	125 W	DDR4-3200 ECC	Ja	UHD P750 (1,3 GHz)
	W-1350	6	3,3 GHz	5,0 GHz	12 MB	80 W	DDR4-3200 ECC	Ja	UHD P750 (1,3 GHz)

Detaillierte Informationen über kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.